

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 05 月)

证券简称: 华润微

证券代码: 688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>05 月 10 日 15:00-16:00</u> 华西证券 景顺长城基金 <u>05 月 11 日 10:00-11:00、14:00-16:00</u> 东北证券 方正证券 华创证券 中欧基金 南方基金 国泰基金 大成基金 东方基金 诺德基金 长盛基金 天弘基金 中加基金 摩根华鑫基金 鹏扬基金 银河基金 银华基金 英大基金 方正富邦基金 北京成泉资本 富道基金 国联安基金 国寿安保基金

	合众资产 恒大人寿 华夏久盈 华夏未来 幻方量化 江南泽融投资 金塔投资 九泰基金 南华基金 奇点资产 钦沐资产 人寿养老 深圳前海君创 深圳正圆投资 陶朱资本 天安财险 益民基金 长城财富保险 长城证券自营 中信建投证券资管 中信证券自营 中银国际资管 中再资产 <u>05月26日 14:00-15:00</u> 天风证券 国金基金 华能贵诚 东盈投资 汇鑫投资 和信金创 斯米克集团 恒晟投资 <u>05月27日 14:30-15:30</u> 国盛证券 长信基金
时间	05月10日 15:00-16:00; 05月11日 10:00-11:00、14:00-16:00; 05月26日 14:00-15:00; 05月27日 14:30-15:30;
地点	华润微电子会议室、上海策略会
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事会秘书兼战略总监

投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司对今年下半年市场行情的展望？ 当前市场景气上行，供需紧张的局面短期内无法得到有效的缓解。从公司在手订单和客户库存水位来看，公司对今年后势保持乐观的态度。 问题二：公司今年一季度的毛利率提高的原因？ ①公司去年四季度产品销售价格和代工价格的提升在今年一季度有所显现。 ②公司收购了东莞杰群 70%的股份并在去年9月末并表，东莞杰群和公司内部的协同效应开始逐步显现，公司一些功率产品的封装瓶颈取得了突破，公司进一步切入高端应用领域和客户。 问题三：公司对 2021 年毛利率的后续展望？ 目前市场需求旺盛，随着公司有序扩充产能、内部经营效率提升和客户结构改善，公司对今年整体毛利率提升保持谨慎乐观的态度。 问题四：目前来看，公司哪些下游需求增速较快？ 2020 年下半年以来，在大消费、5G、数据中心、新基建等政策刺激下，消费电子、家电、工控、汽车、新能源等下游行业回暖，功率半导体产品需求旺盛，供需紧张，行业进入高景气阶段，同时功率半导体国产替代市场空间巨大。 问题五：目前市场产能紧张，是否存在重复下单的情况？ 公司认为存在一些重复下单的行为，但客户库存水位处在较低水平，公司认为后续市场对于功率器件的需求依然会保持强劲的势头，产能紧张的问题在今年仍然会持续。 问题六：公司未来是否考虑采取进一步涨价的措施？ 公司会根据市场变化情况，也会关注原材料价格变化等因素综合考虑价格策略。 问题七：请问公司产品的成本端是否有价格增长？ 目前国产八吋硅片的供应整体量相对充分，国
----------------------	--

	产八吋硅片价格相对稳定。国外硅片的供应商受疫情和产能紧张的影响,会出现供应紧张的局面,价格有一定调整,2021 年一季度产品主材价格有一定幅度的提升,辅材价格未有大幅波动。 问题八：公司各业务板块在营收中的占比？ 2020 年公司代工业务占公司整体营收的比重约为 55%，产品业务比重约为 45%。未来公司将进一步提高产品业务的占比,持续向一体化的产品公司转型。 问题九：公司目前产品业务中的客户结构情况？未来客户结构是否会有调整？ 目前公司的自有产品中,约 70%用于消费类电子,其余产品主要用于工业控制和汽车电子类。未来公司将进一步提高工业控制和汽车电子的产品。 问题十：公司对于 MEMS 产品有哪些规划？ 公司 IPO 募投项目中,8 吋 MEMS 的 3000 片/月产能扩充已经完成,可以投入使用。 公司光电及硅麦克风传感器工艺平台从 6 英寸升级到 8 英寸,实现批量生产,产品性能及良率水平优秀;整体提升了公司 MEMS 工艺技术水平和竞争能力。 问题十一：IGBT 产品发展情况,下游应用开拓情况以及未来产品规划？ 2020 年公司 IGBT 产品销售额突破一亿元,营收同比增速超 70%,IGBT 模组目前已开始销售。 受益于 IGBT 国产替代进程加快,电磁炉、跑步机等消费级市场、电焊机、逆变器、变频器等工控市场需求上升,带动了公司 IGBT 产品订单增长。公司逐步向变频器、UPS/逆变器、移动储能等工业领域拓展,有序推进产品在客户端的认证与上量。 问题十二：公司在年报中披露 MOSFET 产品已突破 20 亿元,如何看待后续国产替代的空间？
--	--

	目前国内约 90%的 MOSFET 高端产品市场份额仍被国外厂商占据，公司正在积极布局中高端领域，未来国产替代空间大。 问题十三：公司今年超结 MOS 业务的进展？ 公司超结产品已规模上量，公司今年对超结产品做了产能结构的调整，增加了产能供给，预计今年超结产品可以实现快速增长。 问题十四：近期 LED 产品有较大涨幅，公司对于 LED 产品有哪些规划？ 公司会加大 LED 产品在汽车照明领域的占比。 问题十五：公司今年在第三代化合物半导体方面有哪些进展？ 公司拥有国内首条 6 吋商用 SiC 生产线，SiC 二极管产品已实现销售额突破，预计今年将进一步推出 SiC MOSFET 产品；GaN 产品 6 吋和 8 吋平台正在同步开展研发，计划在今年向市场推出有关产品。 问题十六：公司如何平衡自有产品和代工客户的产能？ 公司对标先进企业，向综合一体化产品公司转型，公司会保障原有代工客户的产能，代工业务也会增长，对于今年新增的晶圆制造产能，将更多地向自有产品倾斜。 问题十七：公司在晶圆制造方面，今年会新增产能吗？ 公司将会通过技改项目扩充部分产能。 问题十八：公司 12 吋产线何时可以贡献产能？目前规划的产能是多少？ 公司 12 吋产线预计在 2022 年可以实现产能贡献；目前该产线规划月产能为 3 万片，未来将主要用于自有功率器件产品的生产。 问题十九：公司定增项目的规划，何时可以贡献产能？ 公司希望明年功率器件的封装产线开始量产
--	---

	用于自有产品。 问题二十：公司内部未来几年的整体规划目标？ 公司希望在未来 5-10 年成为世界领先的功率半导体和智能传感器的产品与供应商。 问题二十一：请问公司对于市场开拓与客户导入方面有哪些优势？ 公司客户基础庞大多元，与众多客户保持多年紧密的合作关系，长期以来与之共同成长。同时，公司不断加大研发投入和产品创新力度，向客户提供高质量一体化产品和服务，客户结构持续优化。 问题二十二：请问公司在半导体制造方面有哪些优势？ 公司具有全国领先的半导体制造工艺水平，BCD 工艺技术水平国际领先、MEMS 工艺等晶圆制造技术以及智能功率 IPM 模块封装等封装技术国内领先。 公司的制造资源在国内处于领先地位，目前拥有 6 吋晶圆制造产能约为 248 万片/年，8 吋晶圆制造产能约为 144 万片/年。 问题二十三：公司晶圆产线的国产化率？ 公司致力于提升供应链自主可控能力，优先发展国产供应商，深化本地化采购政策。 目前公司八吋线国产化材料采购比例高于国内平均水平。 问题二十四：公司在外延并购方面的进度？ 公司未来外延的方向重点关注功率半导体和智能传感器相关的产品公司。 公司对于投资并购的标的选择有三个方向：有一定规模的上市公司；培育有潜力的初创公司，利用现有制造能力补强产品系列；与海外公司或团队，进行技术引进或合作开发等。 问题二十五：公司怎么留住研发人员和优秀人才？ 公司对于研发人员采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励
--	---

	等制度；同时公司正在积极推进上市公司股权激励方案。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 05 月